

※本リリースは鉄鋼研究会へ配布しております。

2023年1月17日

TANAKA ホールディングス株式会社

田中貴金属グループ EEJA、
「第 37 回 インターネブコン ジャパン」に出展
エレクトロニクス産業の新たなニーズに応える
通信および車載関連の電子部品／半導体、樹脂関連めっきの新製品を初公開

田中貴金属グループのめっき事業を展開する EEJA 株式会社（本社：神奈川県平塚市、代表取締役社長執行役員：庄司 亨）は、2023年1月25日(水)～27日(金)に東京ビッグサイトで開催されるエレクトロニクスの実装・製造展「第37回 インターネブコン ジャパン」に出展することを発表いたします。4年ぶりの出展となる本展示会では、通信環境におけるデータ量の増大や車載電子部品／半導体の耐久性向上など、エレクトロニクス産業の新たなニーズに応える、めっき技術／プロセスに関する4つの新製品を一挙初公開いたします。



<SEADCAT200 シリーズ>

本出展は2019年以来4年ぶりとなりますが、その間にも、電子部品の主な使用領域がローカル使用からネットワーク使用に移行し、通信業界ではデータ量の増大と通信速度の高速化に対応する5G（第5世代移動通信システム）への移行など、求められる技術はより高度化しています。また、自動車産業においても、特にエンジン周辺への電子部品や半導体の搭載増加に伴い、耐熱性／耐湿性などの点で過酷な環境試験に耐えうる製品が求められています。

EEJAでは、田中貴金属グループとして長年培った貴金属の技術を生かし、半導体や電子部品などエレクトロニクス産業に不可欠なめっき技術と製品を開発・提供してきました。年々変化するお客様の様々なニーズにお応えすべく、それぞれの用途に応じためっき特性と、生産性の高いプロセスを日々新たに研究開発しています。EEJAは、本展示会でご紹介する4つの新しいめっき技術ならびに、高密度化するウエハーへの柔軟な対応を可能にしためっき装置により、今後さらに高度化

が求められるエレクトロニクス産業において、多種多様なニーズにお応えするとともにさらなる技術革新に貢献してまいります。

【第 37 回 インターネプコン ジャパン 出展概要】

■会期：2023 年 1 月 25 日（水）～27 日（金） 10:00～17:00

■会場：東京ビッグサイト EEJA 株式会社出展ブース《東展示場 2 6 - 1》

■主な展示内容：

| 製品名 | 概要 |
|---|---|
| 高硬度/高耐食性 Pt 及び Pt 合金めっきプロセス 「PRECIOUSFAB Pt2000/HP3000」(新製品) | 車載に代表される耐久性及び耐環境性能が求められるコネクタの接点部分への表面処理に応用することで高い信頼性を得ることが可能です。 |
| Pd ダイレクト・ノンシアン無電解 Au めっきプロセス 「AC FAB Au-IAG1000」(新製品) | 半導体パッケージ部品への表面処理に採用されている Ni/Pd/Au めっき工程へ応用することでプロセス簡略化と腐食を抑制した高品質な成膜が可能です。 |
| 硬度・外観の安定性を向上した ノンシアン電解 Au めっきプロセス 「MICROFAB Au2108/Au2168」(新製品) | ファインピッチ化・高密度化が進むウエハー上の Au バンプ形成において、外観の安定性と硬度の安定化を図り、製品歩留まり及び信頼性の向上が期待できます。 |
| ダイレクトパターンニングめっき技術 「SEADCAT200 シリーズ」(新製品) | SEADCAT100 シリーズから対応可能な素材種類が増えました。SEADCAT PRM200-MRG：LCP や一部フッ素系樹脂への密着性を高め、耐熱性/耐湿性も向上させました。 SEADCAT PRM200-MDI：ポリイミド上への銅配線形成後の熱処理による銅の拡散を抑制することができます。 |
| 開発実験対応プレイティングシステム 「RAD-Plater」(めっき装置) | 高密度化するウエハー上へのパターンめっきの際に面内分布を向上させるシステムとなっており、メモリーの再配線から MEMS まで幅広いウエハーへの対応が可能です。 |

その他各種めっきプロセスとめっき装置の詳細は下記 URL よりご覧いただけます。

■ 各種めっきプロセス

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/products/detail/plating-processes/>

■ めっき装置

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/products/detail/plating-equipment/>

めっき装置はグループ会社の三友セミコンエンジニアリング株式会社で取り扱っております。

<https://mitomo-semicon-eng.co.jp/>

【EEJA 株式会社】

本社所在地：神奈川県平塚市新町 5-50

設立：1965 年 代表者：代表取締役社長執行役員 庄司 亨

資本金：1 億円 売上高：380 億 9,200 万円 2021 年度（2022 年 3 月期）

従業員数：127 名（海外拠点含む）（2022 年 3 月 31 日）

事業内容：貴金属・卑金属めっき液、添加剤および表面処理関連薬品の開発、製造、販売、輸出

■田中貴金属グループについて

田中貴金属グループは 1885 年（明治 18 年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年に渡って、産業用貴金属製品の製造・販売ならびに、資産用や宝飾品としての貴金属商品を提供しています。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術開発において連携・協力し、製品とサービスを提供しています。

2021 年度（2022 年 3 月期）の連結売上高は 7,877 億円^(※)、5,225 人の従業員を擁しています。

※当連結会計年度より収益認識に関する会計基準の適用により、売上高は一部の取引において純額表示しております。

■産業事業グローバルウェブサイト

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/>

■製品問い合わせフォーム

田中貴金属工業株式会社

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/inquiries-on-industrial-products/>

■報道機関問い合わせ先

TANAKA ホールディングス株式会社 サステナビリティ・広報本部

<https://tanaka-preciousmetals.com/jp/inquiries-for-media/>